

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2019-78707(P2019-78707A)

【公開日】令和1年5月23日(2019.5.23)

【年通号数】公開・登録公報2019-019

【出願番号】特願2017-207839(P2017-207839)

【国際特許分類】

G 01 N 35/08 (2006.01)

G 01 N 37/00 (2006.01)

【F I】

G 01 N 35/08 A

G 01 N 37/00 101

【手続補正書】

【提出日】令和2年2月28日(2020.2.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

樹脂からなる第1の基板および樹脂からなる第2の基板が接合されてなり、少なくとも第1の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第1の基板と前記第2の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度 α_1 が、 $\alpha_1 > 90^\circ$ を満足し、

前記接合面、および前記第2の基板における前記第1の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が500μm以上であることを特徴とするマイクロチップ。

【請求項2】

前記非接触部の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度 α_2 が、 $\alpha_2 > 90^\circ$ を満足することを特徴とする請求項1に記載のマイクロチップ。

【請求項3】

樹脂からなる第1の基板および樹脂からなる第2の基板が接合されてなり、少なくとも第1の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第1の基板と前記第2の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面および前記非接触部の側壁面の少なくとも一方において、当該側壁面に連続する接合面に接近した箇所がC面取り形状またはR面取り形状とされており、

前記接合面、および前記第2の基板における前記第1の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が500μm以上であることを特徴とするマイクロチップ。

【請求項4】

前記第1の基板および前記第2の基板の周縁部の少なくとも一部において、当該第1の基板と当該第2の基板との接合部が形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項

3のいずれか一項に記載のマイクロチップ。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

本発明のマイクロチップは、樹脂からなる第1の基板および樹脂からなる第2の基板が接合されてなり、少なくとも第1の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第1の基板と前記第2の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面とこれに連続する接合面とのなす角度 γ_1 が、 $\gamma_1 > 90^\circ$ を満足し、

前記接合面、および前記第2の基板における前記第1の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が500μm以上であることを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0012】

また、本発明のマイクロチップは、樹脂からなる第1の基板および樹脂からなる第2の基板が接合されてなり、少なくとも第1の基板に形成された流路形成用段差によって、前記第1の基板と前記第2の基板との接合部に包囲された流路が形成されたマイクロチップであって、

前記接合部を包囲する非接触部が形成されており、

前記流路用形成用段差の側壁面および前記非接触部の側壁面の少なくとも一方において、当該側壁面に連続する接合面に接近した箇所がC面取り形状またはR面取り形状とされており、

前記接合面、および前記第2の基板における前記第1の基板に接する側の表面は、それぞれ平坦であり、

前記接合面の幅が500μm以上であることを特徴とする。